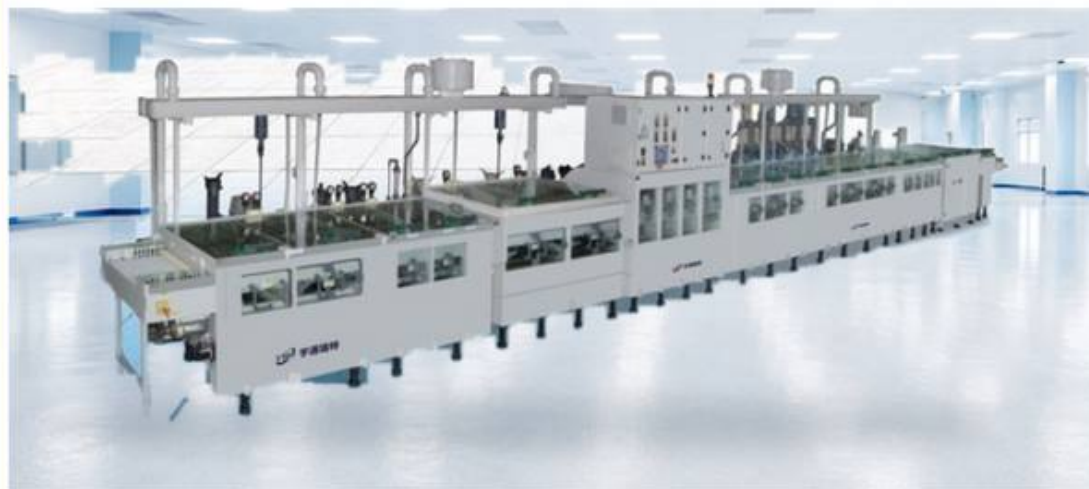


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

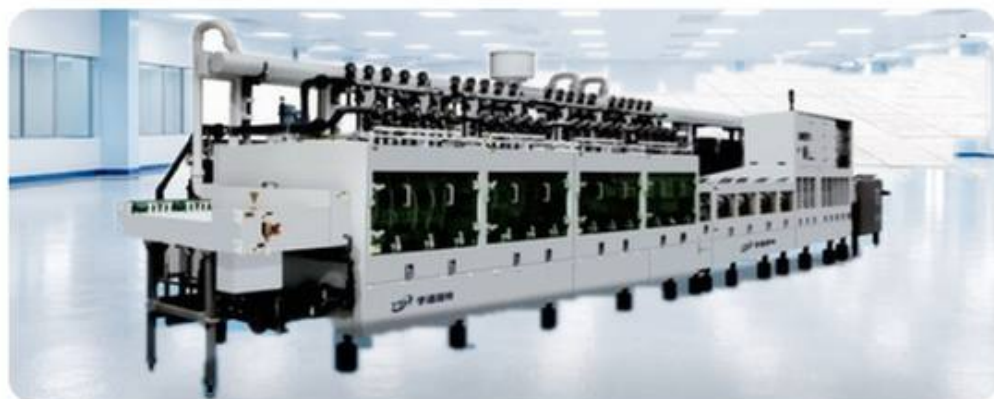
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ПРОЯВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНОЙ МАСКИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Качающаяся система распыления с регулировкой давления.
- Равномерное проявление мелких отверстий.
- Мониторинг концентрации и температуры раствора.
- Контроль качества промывки и сушки.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Проявление жидкой фотополимерной паяльной маски с последующей промывкой.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультразвуковая и высоконапорная мойка.
- Фильтрация технологического раствора.
- Водяной нож и контроль качества промывки.
- Датчики предотвращают застревание плат.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Финишное удаление остатков химии и механических загрязнений.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

